

2021年第三季法人說明會

長華*(8070.TW)
(每股面額1元)

2021/11/9

會議議程

- 2021年第三季營運成果
- Q&A

前瞻性聲明

本簡報中所提及的非歷史性訊息為「前瞻性資訊」，本公司提醒讀者本簡報所提及之前瞻性資訊係基於本公司擁有之合理知識與當前預期，此類前瞻性資訊將受各種風險與不確定性所影響。

由於各種因素，實際結果可能與本簡報中所提及的前瞻性資訊存在重大差異，包括但不限於供需變化的風險、製造與供應能力、設計上的勝利、上市時間、市場競爭、行業週期性、客戶的財務狀況、匯率波動、法律訴訟、法規修訂、全球總體經濟變化、自然災害以及其他可能影響本公司業務與營運的突發事件。

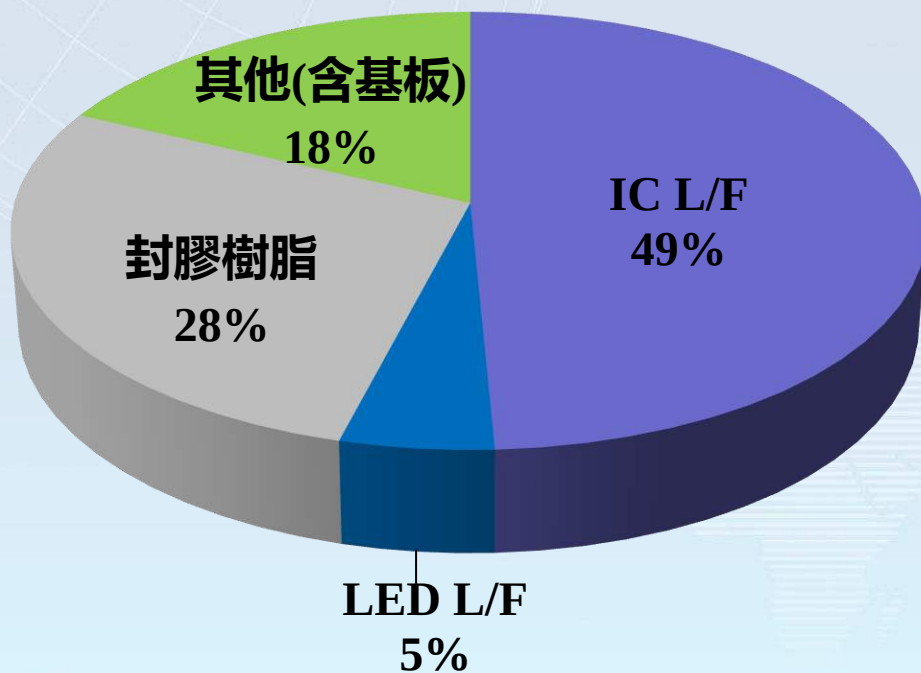
因此，讀者不應依賴任何前瞻性資訊。除法令要求外，本公司並無義務因應新資訊的產生、未來事件的發生或其他原因主動更新對於此前瞻性資訊的陳述。

綜合損益表

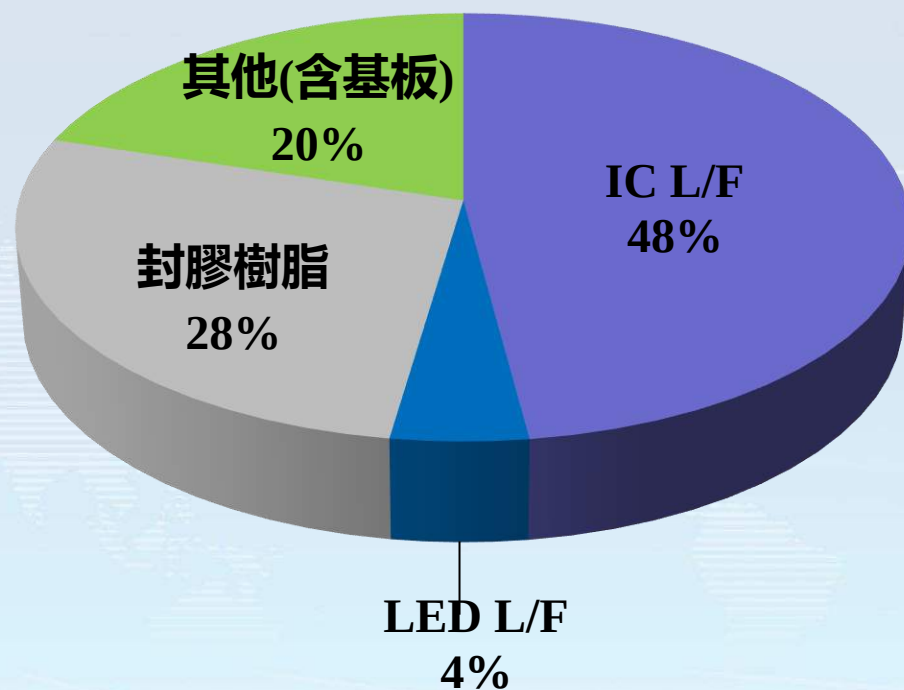
新台幣百萬元	Y2021 3Q	Y2021 2Q	QoQ	Y2020 3Q	YoY
營業收入淨額	5,472	4,901	12%	4,082	34%
營業毛利	1,157	871	33%	620	87%
營業利益	747	563	33%	310	141%
營業外收入及支出	396	30	1220%	224	77%
稅前淨利	1,143	593	93%	534	114%
所得稅費用	180	120	50%	(9)	2100%
本期淨利歸屬於母公司業主	703	338	108%	415	69%
基本每股盈餘(新台幣元)	1.02	0.49	108%	0.65	57%
財務比率(%)					
毛利率	21.1%	17.8%		15.2%	
營業利益率	13.7%	11.5%		7.6%	
稅前淨利率	20.9%	12.1%		13.1%	
淨利率	17.6%	9.7%		13.3%	

產品組合

2021 Q1 ~ Q3



2020 Q1 ~ Q3



資產負債表

單位：NTD百萬元

	3Q21	2Q21	3Q20
現金及約當現金	4,340	3,593	3,223
透過損益及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,929	7,191	4,781
採用權益法之投資	3,269	3,122	2,907
應收帳款	4,591	4,105	3,488
存貨	2,328	2,189	1,761
不動產、廠房及設備	2,692	2,651	2,435
資產總計	27,356	26,126	22,055
負債總計	16,043	15,687	13,947
股東權益總計	11,313	10,439	8,108

轉投資公司持股價值

轉投資公司/ 新台幣百萬元	長科*(6548)	易華電(6552)	濠瑋	華德	銀聯
持股比重	56%	43%	25%	37%	30%
持有股數(2021/9/30)	200,267,970	35,531,390	17,000,000	19,314,164	300,000
帳上金額(2021/9/30)	3,655	1,742	755	443	329
每股市價(元/2021/10/29)	104.00	58.60	-	-	-
估算市值	20,828	2,082	-	-	-

現金流量表

單位：NTD百萬元	3Q21	2Q21	3Q20
期初現金	3,593	3,094	4,357
營運活動之現金流入	988	342	338
資本支出	(166)	(270)	(102)
現金股利	(701)	-	(543)
長短期借款(含公司債)	1,097	155	1,553
投資	(46)	142	(1,004)
其他	(425)	130	(1,376)
期末現金	4,340	3,593	3,223
自由現金流量	822	72	236

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

長華電材合作夥伴在台灣投資新產線

長華電材所代理的原廠—日本Sumitomo Bakelite Co. Ltd.，於11月8日宣布封膠樹脂（Molding Compound）將在現有的台灣廠區增設新產線。

https://www.sumibe.co.jp/topics/2021/it-materials/1029_01/index.html

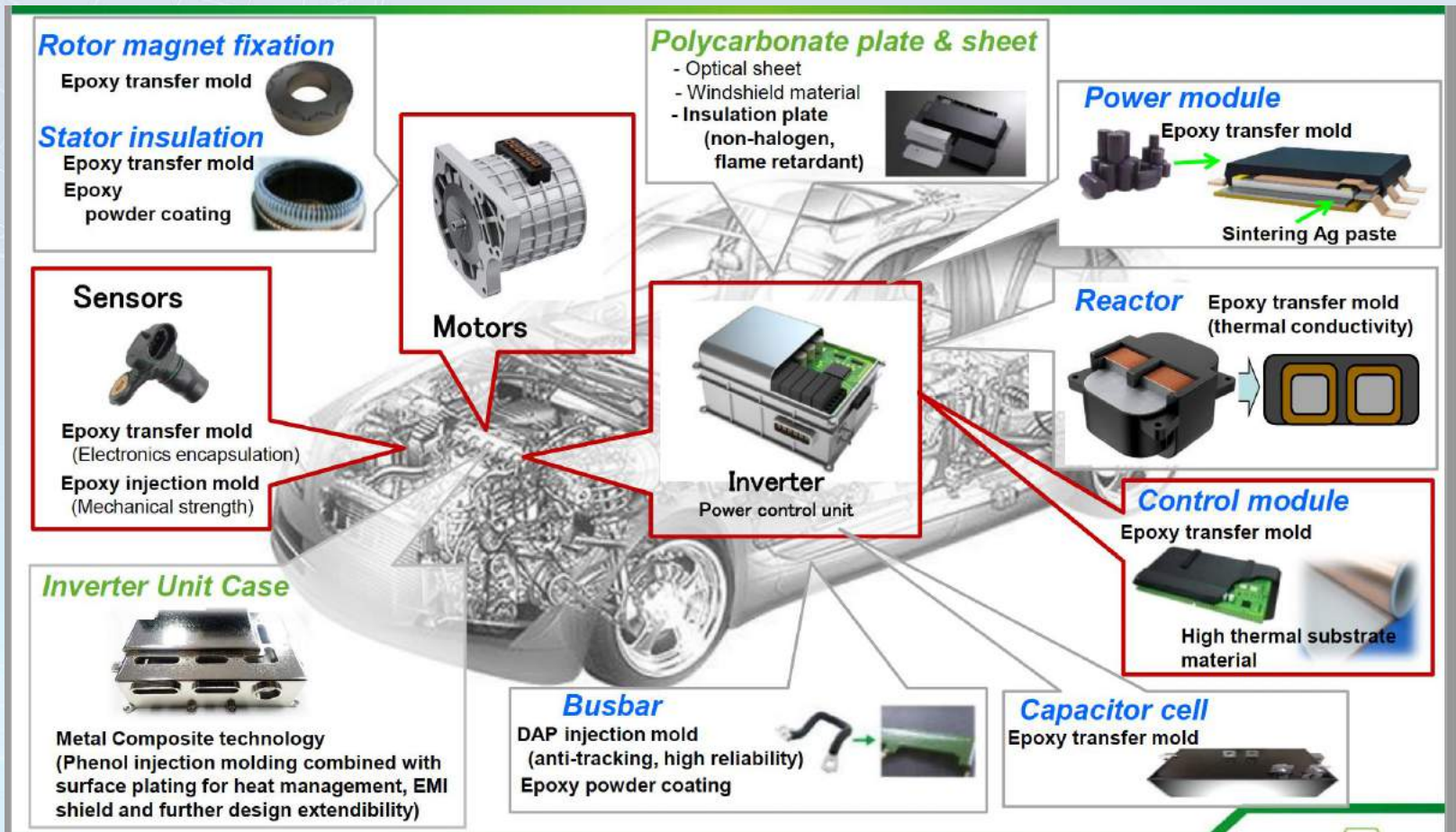


現在住友培科工廠外觀



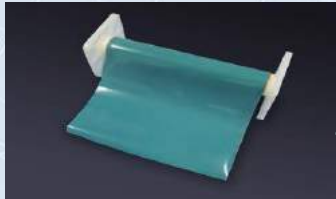
環氧樹脂封裝材料(Molding Compound)

擴展銷售產品類別(1)

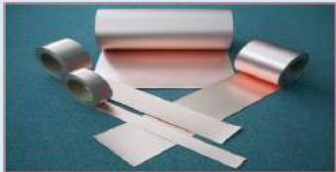


擴展銷售產品類別(2)

卷式的封裝載板原材



High Stiffness Solder Resist Film

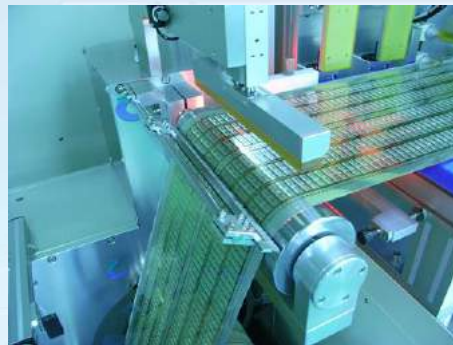


Core

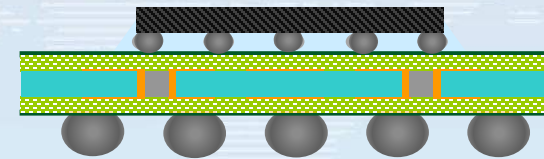


Prepreg

卷對卷式生產



封裝載板



Q&A